

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司

关于全资子公司申请银行授信暨提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于2024年4月28日召开第二届董事会第十六次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，公司2024年度拟向金融机构申请综合授信额度共计不超过人民币捌亿元，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币伍亿元的担保额度，该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂。具体融资金额将视公司及合并报表范围内的子公司运营资金的实际需求来确定。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会之日。在授权期间，上述授信与担保额度可循环使用。

公司全资子公司瑞能微恩半导体（北京）有限公司因经营发展业务需要，现与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署《固定资产贷款合同》，申请综合授信额度人民币35000万元，授信期限为7年。瑞能微恩半导体（北京）有限公司本次银行授信由母公司瑞能半导体科技股份有限公司提供连带责任保证担保，并需在项目投资设备验收后配合贷款人办理设备抵押登记手续。具体期限及其他要素以双方实际签署的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024年4月28日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2024年5月20日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》。普通股同意股数361,633,396股，占股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占股东大会有表决权股份总数的0%。

本次担保是母公司为全资子公司提供担保，在2023年年度股东大会审议通过的授信额度及担保范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：瑞能微恩半导体（北京）有限公司

成立日期：2021年12月15日

住所：北京市顺义区杜杨北街3号院3号楼(顺创)

注册地址：北京市顺义区杜杨北街3号院3号楼(顺创)

注册资本：40,000万元

主营业务：一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；工业设计服务；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；市场调查（不含涉外调查）

法定代表人：汤子鸣

控股股东：瑞能半导体科技股份有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：246,901,217.44元

2023年12月31日流动负债总额：8,389,127.89元

2023年12月31日净资产：101,503,989.45元

2023年12月31日资产负债率：58.88%

2023年12月31日资产负债率：58.88%

2023年12月31日营业收入：0元

2023年12月31日利润总额：9,406,966.12元

2023年12月31日净利润：8,829,185.17元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

债权人上海浦东发展银行股份有限公司北京分行与债务人瑞能微恩半导体（北京）有限公司于2024年12月11日签署了《固定资产贷款合同》（编号：91052024280385），依据主合同，由债权人向债务人提供的金额为人民币35000万元整的融资。合同项下主债务履行期为2024年12月11日至2031年12月10日。公司作为保证人承担如下主要担保责任：

1、保证方式

本合同项下的保证方式为连带责任保证。

保证人确认，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），债权人均有权先要求本合同项下任一保证人在本合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任。

2、保证范围

本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

3、保证期间

保证期间为至主债务履行期届满之日起一年止。

主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日起一年止。

本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

债权人宣布主债权提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期届满日。

债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的主债务履行期届满之日起三年止。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持子公司经营发展，促进子公司业务进一步提升，公司为子公司借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务经营，符合公司发展战略。子公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

上述对外担保事项，能有效改善全资子公司的财务状况，优化公司融资结构、补充子公司的运营资金，满足其业务发展的资金需求。本次对外担保不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	35,000	22.68%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《瑞能半导体科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《瑞能半导体科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《固定资产贷款合同》

《保证合同》

瑞能半导体科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日